

## Information

2023年5月25日

### 「電子機器トータルソリューション展 2023」出展のご案内

日機装株式会社は、2023年5月31日～6月2日に開催される「電子機器トータルソリューション展 2023」に出展します。

本展示会では、特殊ゲル状加圧媒体を用いた立体的なプレス「3D シンター」、枚葉式積層機「Hi-Stacker」等の製品をご紹介します。また、6月2日(金) 10:15 から NPI セミナー会場にて「パワー半導体接合用のシンタリング装置「3Dシンター」」に関する無料セミナーも開催します。皆様のご参加をお待ちしております。

#### 開催概要

Web サイト	<a href="https://www.jpcashow.com/show2023/index.html">https://www.jpcashow.com/show2023/index.html</a>
会期	2023年5月31日(水)～6月2日(金)
開催時間	10:00～17:00
会場	東京ビックサイト 東展示棟 2～6 ホール + 会議棟
展示ブース	2023 マイクロエレクトロニクスショー「2D-03」 ( <a href="#">出展情報詳細</a> )
無料セミナー	6月2日(金) 10:15～10:35 <展示ホールセミナー会場 G> NPI セミナー会場① 「パワー半導体向け 3D プレス技術とシンタリング(焼結)装置開発のご紹介」 インダストリアル事業本部 精密機器技術センター 技術部開発グループ 牧野 由

#### 本件に関するお問い合わせ先

日機装株式会社 インダストリアル事業本部 精密機器事業  
精密機器東日本営業一部 国内営業グループ <kouatsu-tokyo@nikkiso.co.jp>  
[TEL:03-3443-3753](tel:03-3443-3753)